

证券代码：688138

证券简称：清溢光电

深圳清溢光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研      <input type="checkbox"/> 分析师会议  <input type="checkbox"/> 媒体采访              <input type="checkbox"/> 业绩说明会  <input type="checkbox"/> 新闻发布会              <input type="checkbox"/> 路演活动  <input type="checkbox"/> 现场参观  <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）         </p>						
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>序号</p>	<p>机构名称</p>	<p>参加人</p>		<p>序号</p>	<p>机构名称</p>	<p>参加人</p>
	1	金信基金	刘榕俊		34	源乘投资	蔡振宇
	2	金信基金	黄飙		35	万和投资	马聪
	3	信达澳亚	刘权		36	达昊控股	刘霄
	4	海港人寿	张泽京		37	玄甲私募	李大志
	5	嘉实基金	王宇恒		38	进化论私募	袁月
	7	嘉实基金	彭民		39	望正资本	马力
	8	长城基金	苏俊彦		40	华泰资管	甘华
	9	红土创新基金	汪国瑞		41	中邮证券	王达婷
	10	石锋资产	赵思昊		42	中邮证券	翟一梦
	11	高毅资产	罗晓迪		43	创金合信	郭镇岳
	12	博时基金	何坤		44	创金合信	周志敏
	13	天弘基金	张磊		45	长城证券	黄俊峰
	14	安信资管	杨中国		46	深圳盈泰投资	朱亚光
	15	先锋基金	曾捷		47	华创证券	王帅
	14	睿思资本	张彦琨		48	华创证券	唐栩
	16	世纪证券	李时樟		49	华创证券	耿琛
	17	招商资管	吴彤		50	安信证券	马良
	18	招商资管	何怀志		51	安信证券	程宇婷
	19	笃诚投资	唐琪		52	东吴证券	鲍娴颖
	20	金元基金	张茜		53	运舟资本	吕一闻
	21	Maxcess Capital	周姜宇		54	泽正投资	李屹东
	22	深圳民森	丁凡伦		55	君弘投资	段倩
	23	民泮资产	陈净		56	平安证券	徐勇
	24	前海联合基金	张磊		57	惠升基金	黄兹睿
	25	初华资本	杨明辉		58	中航证券	赵晓琨
	26	初华资本	李献红		59	德讯证顾	阮世旺

	27	同创佳业	林海成		60	德讯证顾	常建武
	28	天风证券	吴雨		61	幸福阶乘基金	张东晓
	29	天风证券	文灿曦		62	湘财证券	李军辉
	30	浙商证券	宋富强		63	中信建投	孙芳芳
	31	浙商证券	陈诗含		64	广发证券	王钰乔
	32	国金证券	丁彦文		65	华安证券	陈耀波
	33	固禾基金	纪晓玲		66	华安证券	陈重伊
<b>时间</b>	2023年10月16日						
<b>地点</b>	深圳清溢光电股份有限公司会议室现场调研						
<b>上市公司接待人员姓名</b>	<p>公司董事：唐嘉盛先生</p> <p>公司副董事长：庄鼎鼎先生</p> <p>公司董事、总经理兼财务总监：吴克强先生</p> <p>公司高级营运总监：熊启龙先生</p> <p>公司市场部总监：朱文东先生</p> <p>公司投资者关系总监：汤鸿晶女士</p> <p>公司董事会秘书：秦莘女士</p> <p>深圳清溢微电子有限公司总经理：侯宏浩先生</p> <p>深圳清溢微电子有限公司市场销售总监：陶飞先生</p>						
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>一、基本情况介绍</p> <p>深圳清溢光电股份有限公司（证券代码：688138，证券简称：清溢光电，以下简称“公司”）成立于1997年8月，注册资本为26,680万元人民币，已于2019年11月20日在上海证券交易所科创板上市。公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。</p> <p>公司主要产品为掩膜版（Photomask），又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等，是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等信息的载体，主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业。</p> <p>2023年上半年，公司营业收入较上年同期增长7,554.60万元，同比增长22.10%，主要系厂商加大新品开发的力度，带动了掩膜版的需求增长，公司接受的订单数量有提升。</p> <p>在“十四五”时期新一代信息技术产业快速发展的背景下，公司坚持战略规划前瞻性和战略实施的系统性与连贯性。在实现2023年战略目标的同时，公司紧紧抓住平板显示和半导体芯片掩膜版国产替代、自主可控等历史性机遇，发挥公司技术、管理、</p>						

服务和成本等方面的优势，调整并整合优势资源，不断完善并拓展自身产品结构和市场布局。与此同时，公司也规划了“平板显示掩膜版+半导体芯片掩膜版”互促共进的“双翼”战略以推动公司快速和高效益的发展。

公司立足中国面向全球，未来通过两座新型智能化的掩膜版生产基地的投建，将进一步扩大产能，提升产品精度和品质，力争成为全球范围内掩膜版行业中产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的行业领先者。

## 二、问答环节

1、进入掩膜版行业的企业越来越多，请问公司面对当前的竞争局势有什么准备吗？尤其是在半导体业务方面。

答：首先，半导体掩膜版的市场容量相对较大，不少投资人进入掩膜版行业，是正常的状态；其次，目前国内的晶圆厂商处于起步阶段，待大量晶圆厂建成后，对掩膜版的需求会大量增加。

公司对当前竞争局势有充分的认识和考量，已制定全面的成长策略：(1)在产能扩张方面，合肥工厂持续扩产，佛山新厂建设正在规划中，未来通过两座新型智能化的掩膜版生产基地的投建，将进一步扩大产能，提升产品精度和品质，力争成为全球范围内掩膜版行业中产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的行业领先者；(2)在技术升级方面，平板显示掩膜版业务领域正在逐步推进6代超高精度AMOLED/LTPS等掩膜版的研发、高规格半透膜掩膜版(HTM)与高规格相移掩膜版(PSM)规划开发，半导体业务领域在开展130nm-65nm半导体芯片掩膜版的工艺研发和28nm半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划，将来在对高端产品的开发支持上公司会有更大的力度；(3)在管理方面，公司将不断提升经营管理效率，升级软件及信息安全等系统。

2、公司佛山生产基地项目分三期建设，请问有没有一些细致的节点可以和各位投资者分享呢？

答：公司拟在佛山市南海区投资人民币35亿元建设佛山生产基地项目，包括“高精度掩膜版生产基地建设项目”和“高端半导体掩膜版生产基地建设项目”，项目情况如下：

投资项目一名称：高精度掩膜版生产基地建设项目。

投资金额：本项目将分三期进行建设，合计拟投资人民币20亿元，其中一期拟投资8亿元；二期拟投资3亿元，三期拟投资9亿元。

项目建设情况：一期、二期项目拟购置土地 50 亩（具体面积以最终挂牌面积为准），自签订《土地出让合同》之月起，在 12 个月内开工建设、36 个月内投产。三期项目将根据宏观环境、市场趋势等情况综合确定及推进。

投资项目二名称：高端半导体掩膜版生产基地建设项目。

投资金额：本项目将分三期建设，合计拟投资人民币 15 亿元，其中一期拟投资 6.05 亿元，二期拟投资 2.95 亿元，三期拟投资 6 亿元。

项目建设情况：一期、二期项目拟购置土地 30 亩（具体面积以最终挂牌面积为准），自签订《土地出让合同》之月起，在 12 个月内开工建设、36 个月内投产。三期项目将根据宏观环境、市场趋势等情况综合确定及推进。

目前，上述佛山生产基地项目在厂房设备以及目标客户等方面已经进行了比较充分的调研和评估，项目涉及的设备在按计划采购中，部分设备已支付定金等款项。

3、请问公司目前半导体掩膜版的制程大概是多少？目前主要设备采购的节奏怎么样？

答：半导体芯片掩膜版技术方面，公司已实现 180nm 工艺节点半导体芯片掩膜版的客户测试认证及量产，同步开展 130nm-65nm 半导体芯片掩膜版的工艺研发和 28nm 半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划。

半导体掩膜版业务方面，公司目前已拥有业内先进的激光光刻机，CD 精度可达到 130nm 掩膜版的要求。佛山生产基地项目拟引入的光刻设备将不限于激光光刻机，也将适时考虑引入电子束光刻机。

由于半导体光刻机的采购周期较长，公司技术方面正在逐步提升，公司将分步投资，具体请关注公司后续披露的相关公告。

4、请问公司半导体业务的客户结构怎么样？

答：公司半导体业务的客户结构与公司产品精度紧密相关。公司半导体业务早期形成的客户主要分布在 IC 载板、发光二极管 LED、封装等行业，囊括了上述行业的头部厂家，例如三安光电、长电科技等，目前在半导体器件方面形成的客户主要分布在功率器件、滤波器件等行业，主要客户有中芯国际、士兰微等。

5、请问公司半导体掩膜版业务出货占比是多少？持续增长的动力是什么？后续 1-3 年是怎样的发展趋势？

答：2023 年上半年公司半导体业务主营业务收入为 6,161.40 万元，在主营业务

中占比为 14.90%。半导体掩膜版业务持续增长的动力主要源于国内晶圆厂的本身的市场需求及其对供应链安全、本地化的服务和交期的迫切需求。

SEMI2023 年报告指出，半导体设备市场在经历了 2023 年的调整之后，预计 2024 年将出现强劲反弹，2024 年将复苏至 1,000 亿美元，其中 2024 年全球 300mm 晶圆厂设备支出预计将增长 12%至 820 亿美元，2025 年增长 24%至 1,019 亿美元，2026 年增长 17%至 1,188 亿美元。中国大陆预计在 2026 年间的支出将从 2023 年的 149 亿美元增加至 161 亿美元。对高性能计算、汽车应用的强劲需求和对存储器需求的提升将推动半导体设备支出的增长。

SEMI2023 年 6 月分析报告中指出，2022 年全球半导体材料市场销售额增长 8.9%，达到 727 亿美元，超过了 2021 年创下的 668 亿美元的前一市场高点。硅、湿化学品和掩膜版等领域在晶圆制造材料市场中表现出最强劲的增长。凭借其 IC Foundry 产能和先进封装的基础，中国台湾地区连续第 13 年成为世界上最大的半导体材料消费地区。中国大陆继续保持强劲的增长，以 129 亿美元的销售额在 2022 年排名第二。中国大陆半导体芯片在成熟制程生产线的投资布局将进一步加速中国半导体产业链的国产化进程，中国大陆半导体芯片、chiplet 先进封装技术将继续加快变革。在半导体芯片掩膜版领域，半导体芯片需求的增加是推动半导体芯片掩膜版市场增长的主要因素。根据 SEMI 在 2022 年的分析报告，2022 年全球半导体芯片掩膜版市场规模约有 52 亿美元，预计 2023 年市场规模将达到 54 亿美元，同比增长 4%。受益于中国大陆半导体芯片制造的快速发展，中国大陆半导体芯片掩膜版市场规模出现快速增长的趋势。综上，未来可预见的期间内，中国大陆半导体芯片行业处于快速发展期，半导体芯片行业掩膜版市场空间巨大。

6、请问公司提供的掩膜版是否是成套的？是否可以分部分提供？

答：公司掩膜版产品可以分部分提供，但鉴于对品质保障的要求，客户一般选择由同一家供应商整套提供。

7、请问合肥清溢目前面板的产能整体的情况以及后续的投产的规划包括公司对长期毛利率的展望？

答：关于产能问题，合肥清溢整体产能受订单结构等因素影响，具体的产能情况以公司信息披露为准。从合肥清溢运营情况来看，工厂实现了自动化的生产线，工艺技术及产品技术持续得到提升，同时随着客户认可度越来越好，高精度产品的比例在

持续稳定地增加，因此总体产能在逐步提升。

关于毛利率的问题，掩膜版行业特点属重资产经营，合肥清溢投资较大，工厂厂房、设备折旧等固定成本较大，毛利率水平受产能利用率等因素影响。受疫情的影响，合肥清溢于 2021 年 4 月投产，投产后产能处于持续稳定爬坡状态。随着产能利用率的逐步提升，合肥清溢毛利率将会稳中有升趋于行业正常水平。

8、公司佛山项目投资较大，请问未来省政府或者国家是否已经有一些扶持政策或有意向中的订单及一些承诺能覆盖投资或其他支出？

答：首先，从公司客户的角度，公司佛山生产基地项目已经有部分目标客户群体，这些客户在大力推广国产化替代，希望项目尽快落地，同时在项目逐渐推进过程中，公司也会与客户保持密切沟通，争取更多的支持。

其次，佛山生产基地项目属于国家支持的产业范围。

9、请问目前上游材料高层石英的国产化的进展是怎么样的？

答：目前很多企业都在推进上游石英玻璃的国产化，上游材料产业链主要包括以下几个环节：一是石英玻璃的生产；二是研磨抛光环节；三是真空镀膜；四是涂胶环节。公司目前已经具备涂胶能力。上游的玻璃、研磨和镀铬环节，国内厂商也在陆续投入，但研磨等方面的技术能力等还需要时间发展；公司大力支持上游材料国产化，未来公司也会综合考虑通过投资等方式推动国产化进程。

10、请问公司目前的市占率？

答：根据公司统计，截至 2022 年底，平板显示掩膜版全球市场销售金额占比为 9% 左右。按公司的战略规划，未来公司力争达到市占率 20-30% 之间。半导体芯片掩膜版方面公司目前没有权威的统计数据参考。

11、对于公司的中长期的发展方向，公司的原料端，是计划继续与国内的供应链体系合作，还是说公司自己在中长期的发展阶段中可能已经掌握了掌握全套的相关技术后，会自己做原料加工？

答：企业处于不同的阶段，发展重心也不同，公司目前重点放在掩膜版部分，并考虑通过扶持国内供应链企业，提供合格的材料，推进国产化的力度，渐进式地实现国产化替代，从而将来在产业链和材料供应上有更多的选择。

	<p>从长远来讲，未来在公司有余力的情况下，不排除在原材料方面有更深入的探讨和推进。</p> <p>12、扶持供应链企业，公司是不是要有一些投入，那是否可能一定程度上也会综合影响公司的成本情况？</p> <p>答：目前公司扶持供应链企业的投入主要包括帮企业产品做一些测试，这部分的成本是相对可控的，不会大幅增加公司的成本。</p> <p>13、公司目前用的部分设备进口的较多，如果公司再往高阶去做的话，会不会遇到一些设备卡脖子的问题？</p> <p>答：目前平板显示业务不涉及设备卡脖子问题。</p> <p>半导体业务如果涉及特别高阶的制程，可能间接涉及卡脖子的问题，公司也一直与设备厂商密切沟通，目前了解到 28nm-130nm 节点工艺的设备是没有问题的。</p> <p>14、公司进口设备中，有没有部分设备可以国产化替代降本？</p> <p>答：目前，公司主要设备尚未使用国产设备，随着国产化的进一步推动，后续在条件成熟的时候也会考虑导入国产化设备。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 10 月 16 日
关于本次活动是否涉及应当披露的重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露的重大信息。